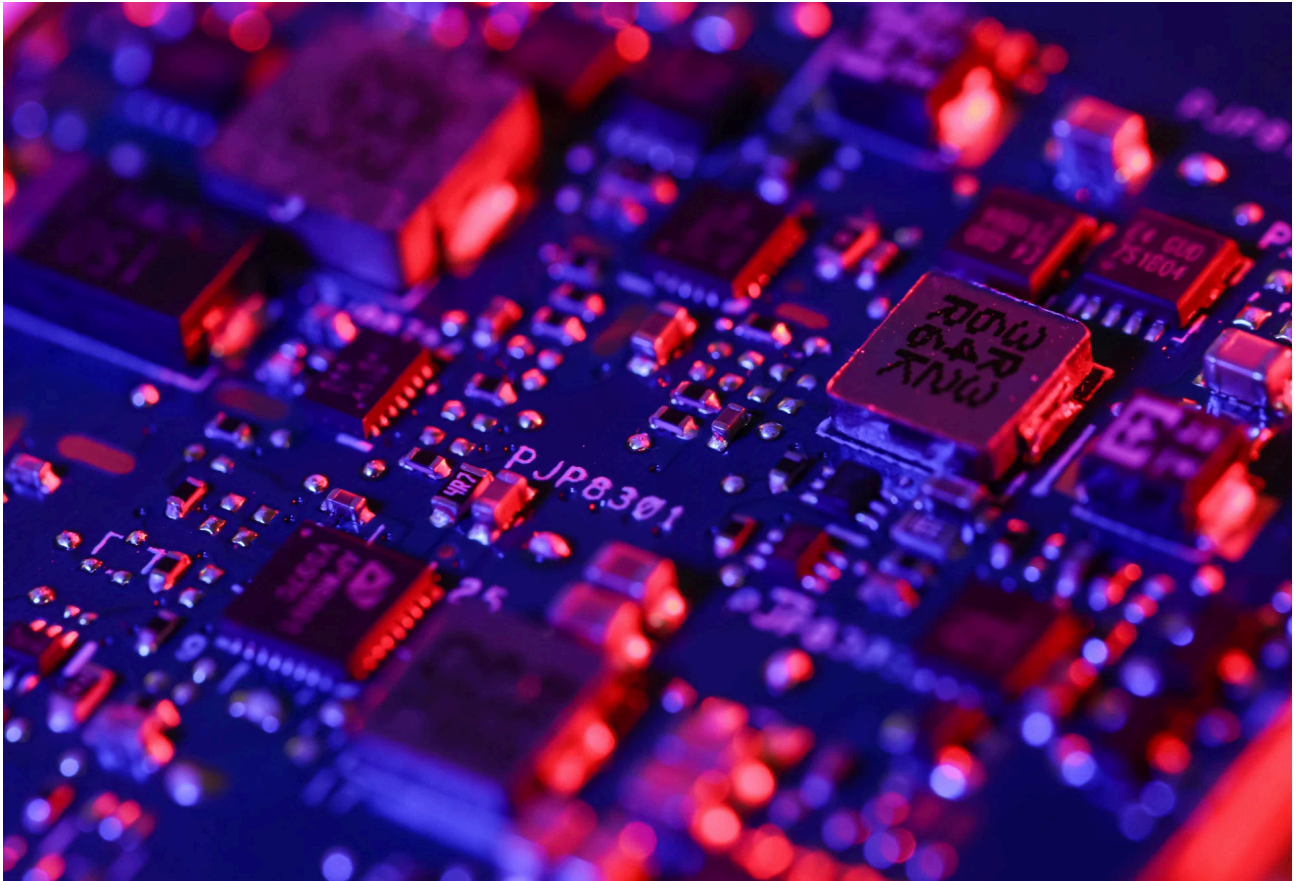


# 人工智能助推半导体市场，大马上市公司Mi Technovation拟分拆材料业务赴新交所上市

BT [businesstimes.com.sg/zh-hans/international/asean/bursa-listed-mi-technovation-seeks-sgx-listing-materials-arm-ai-fuels-semiconductor-rally](https://businesstimes.com.sg/zh-hans/international/asean/bursa-listed-mi-technovation-seeks-sgx-listing-materials-arm-ai-fuels-semiconductor-rally)

Young Zhan Heng

July 22, 2026



总部位于马来西亚的先进制造业封装公司预计将招聘40人，以支持其在新加坡的研发工作

[Young Zhan Heng](#)

Published Thu, Jul 23, 2026 · 07:00 AM

[新加坡] 在大马交易所上市的Mi Technovation正计划将其半导体材料业务在新加坡交易所（SGX）上市，因为人工智能热潮持续推动全球芯片供应链的投资。

在投资者纷纷涌入芯片相关股票的背景下，该公司做出了上市决定。这得益于市场预期先进芯片制造的需求将保持强劲。

今年，在新加坡上市的半导体相关公司股价飙升。

AEM : AWX -5.22%年初至今上涨了425%，而 UMS Integration : 558 -5.73%和 Frencken Group : E28 -3.66%的股价则分别上涨了122.7%和97.1%。

Mi Technovation的股价今年在马来西亚交易所也上涨了97.6%。

总部位于马来西亚的Mi Technovation执行董事兼集团首席执行官Oh Kuang Eng表示，在新加坡上市的决定是在考虑了人才渠道、透明度以及研究人员素质等多种因素后做出的。

他告诉《商业时报》：“新加坡得分最高。”他补充说，公司也曾考虑过其他市场。

他表示，新加坡的地缘政治稳定，并且邻近其位于新柔特别经济区的士乃（Senai）建厂计划，这些也是决定在新加坡上市的原因。

## 仅仅是“第一波”

---

Oh认为，尽管该行业的股票已实现强劲上涨，但芯片产业当前的上升周期并未结束。

他说：“下一波浪潮可能会更高……所以我想说，现在为时未晚。”

该首席执行官预计，下一阶段的增长将由芯片制造商日益增长的需求所驱动。

计划上市的业务部门Mi Material主要生产用于先进半导体封装的焊球。

Oh说：“芯片本身的性能取决于我们的合金和焊球。”

该首席执行官表示，他不知道东南亚有任何其他公司生产这些特定组件，其在该领域的主要竞争对手是日本和韩国公司。

该公司主要将其产品出口到全球最大的半导体生产地台湾。

Mi Technovation于2021年以2.71亿令吉（6630万美元）收购了台湾公司Accurus Scientific 99%的股份，并计划在今年将该公司并入其新加坡控股公司Mi Material。

## 即将在新加坡扩张

---

虽然该公司的设备部门总部设在檳城，但Mi Technovation已在新加坡开展业务。

这家芯片设备制造商目前在新加坡聘有约20名员工，担任高级管理和财务总监等职务，并计划在今年晚些时候研发（R&D）设施启用时扩充人手。

即将启用的新加坡研发设施预计将支持用于先进半导体制造的下一代焊接材料的开发和测试。

为支持研发工作，Oh预计将在新加坡招聘约40名研究人员，不过他表示，招聘计划将在项目启动时才会更加明朗。

虽然他预计下一波芯片需求会更大，但他对资本市场可能作何反应仍持谨慎乐观态度。

他说：“半导体专家所看到的，不一定与资本场所看到的一样。”

此翻译对您是否有帮助？